

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於僅屬概要，故並無載列可能對閣下而言屬重要的所有資料，並須與本文件全文一併閱讀，以確保其完整性。閣下在決定[編纂]前，應細閱整份文件。

任何[編纂]均涉及風險。與[編纂]相關的若干特定風險載於「風險因素」。閣下在決定[編纂]前，應細閱該節。

概覽

我們是誰

我們是中國市場內一家具有穩固市場地位的功率半導體器件供應商，專注於高性能功率半導體器件的研發、設計與銷售，尤其是我們的WLCSP產品（為我們的關鍵產品之一）採用了先進半導體封裝技術，憑藉其產品尺寸小、散熱性能強、抗衝擊性強等特點而聞名。我們的功率半導體器件為用於控制、轉換及管理電力的元件，確保以合適的電壓及電流為不同的設備輸送電力，其由以下各項組成(i)中低壓產品，根據封裝方式，其可進一步分為WLCSP和非WLCSP產品，並被廣泛應用於消費電子、汽車電子及工業電源等領域，及(ii)高壓產品，其被設計用於承受更高的電壓並在更嚴苛的環境下可靠地運行，被廣泛應用於汽車電子及工業應用。

我們專注於產品的設計、研發及銷售，同時將大部分晶圓製造、封裝及測試工藝外包給值得信賴的第三方合作夥伴。同時，我們保留若干關鍵晶圓製造以及封裝及測試工藝的自主能力，主要包括(i)關鍵後道晶圓加工步驟（主要包括晶圓鍍膜、背面研磨及背金），這對實現器件的低導通電阻、高效散熱及高載流能力至關重要，並直接影響產品良率及可靠性；及(ii)WLCSP的封裝及測試工藝，這確保了先進封裝技術的自主可控。基於該模式，我們能夠在開發的較早階段發現並解決技術問題，更高效地實行設計及工藝修改，並減少對第三方封裝及測試服務供應商的依賴，從而能夠縮短產品設計、原型驗證及工程迭代之間的周轉時間，進而加快產品開發及產品迭代。這種混合業務模式結合了外包標準化製造的靈活性與內部製造能力，使我們能夠保持供應鏈的靈活性，並實現有效的成本及質量控制。有關我們業務模式的進一步資料，請參閱「業務－我們的業務模式」。

我們若干關鍵晶圓製造以及封裝及測試工藝的內部能力維持在我們的珠海工廠。我們於2024年設立珠海工廠對我們的財務表現及利潤率作出了重大貢獻。自我們的珠海工廠於2024年底開始量產後，我們實現了外包成本降低及規模經濟改善。例如，我們內部製造的WLCSP產品的單位成本始終低於外包加工的單位成本。由於內部製造WLCSP產品的比例不斷增加，自2024年至2025年，WLCSP產品的整體單位成本下降約23.4%，而截至2026年5月31日止五個月較2025年同期下降約7.7%。我們WLCSP產

概 要

品的毛利率由2024年的18.6%上升至2025年的31.7%。我們的毛利率由截至2025年5月31日止五個月的28.8%減少至截至2026年5月31日止五個月的23.9%，同時成本效益的改善部分抵銷了行業內的定價壓力，減緩了我們毛利率的整體收縮。有關詳細討論，請參閱「財務資料－歷史經營業績回顧－收入」、「銷售成本」以及「毛利及毛利率」。根據灼識諮詢的資料，我們是中國少數同時具備關鍵晶圓製造工藝及先進封裝與測試內部能力的功率半導體器件提供商之一。有關我們的混合業務模式與IDM及無晶圓廠模式相比所面臨典型挑戰的進一步資料，請參閱「行業概覽－功率半導體器件行業概覽－功率半導體器件行業產業鏈」及「－中國功率半導體器件行業競爭概覽－中國功率半導體器件行業競爭格局」。

我們的多元化產品組合及應用

我們提供全面的功率半導體器件產品組合，以額定電壓600V為常規閾值，產品可分為(i)中低壓功率半導體器件和(ii)高壓功率半導體器件。600V的閾值在功率半導體行業中獲廣泛認可為中低壓與高壓器件之間的標準分界線，乃由於其代表了設計為直接由電網運行且具備適當安全裕度的器件通常所需的最低額定電壓。具體而言，

- **中低壓產品：**就功率半導體器件結構而言，我們的中低壓產品主要包括Trench MOSFET及SGT MOSFET。我們的中低壓產品被廣泛應用於消費電子、汽車電子及工業應用。我們的中低壓功率半導體器件按封裝方式進一步分為(i)採用先進WLCSP封裝工藝技術的WLCSP產品，其為半導體行業普遍採用的先進封裝技術，及(ii)採用其他方式封裝的非WLCSP產品，例如PDFN、DFN、TOLL和SOP方法。我們的WLCSP產品憑藉其產品尺寸小、散熱性能強、抗衝擊性強等特點，是智能手機、平板電腦和可穿戴電子設備等鋰電池保護應用的關鍵元件。我們的非WLCSP產品廣泛應用於消費電子、工業電子及汽車電子，包括但不限於手機電源管理及充電器、無人機及汽車域控制系統。雖然WLCSP產品通常用於緊湊型便攜式設備，但我們的非WLCSP產品在更廣泛的應用場景中仍然不可或缺。
- **高壓產品：**就功率半導體器件結構而言，我們的高壓產品主要包括IGBT、SJ MOSFET及Planar MOSFET。這些產品專為滿足嚴苛環境下對高耐壓、高功率密度和可靠性能的需求而設計，被廣泛應用於汽車電子及工業應用等應用場景。

我們的WLCSP技術

我們關注到WLCSP技術對提升功率半導體器件性能及下游應用的推動作用，並戰略性佈局WLCSP技術。WLCSP是一種採用先進工藝的封裝技術，無需樹脂或引線鍵合。WLCSP具有多種優勢，包括尺寸緊湊、電氣性能優異和散熱能力出色，廣泛應用於智能座艙、智能可穿戴設備等高性能應用。根據灼識諮詢的資料，我們的WLCSP

概 要

產品具備以下特點：(i)封裝厚度低至0.095mm，遠薄於傳統封裝；(ii)芯片與封裝面積比接近1:1，大於傳統封裝；及(iii)較傳統BGA/QFN封裝體積縮小約66%。

我們的自主製造及封裝能力

我們若干關鍵晶圓製造以及封裝及測試工藝的自主能力維持在我們的珠海工廠，該工廠於2024年開始營運。我們的珠海工廠專門從事晶圓加工及先進封裝及測試。我們的珠海工廠通過IATF 16949汽車質量管理體系認證。配備最先進的製造設備，珠海工廠支撐專有技術的商業化應用。

我們在珠海工廠進行(i)若干特定後道晶圓加工步驟，如晶圓鍍膜、背面研磨及背金；及(ii)WLCSP的封裝及測試工藝，在滿足嚴苛質量要求與定制化需求的同時，保障高效交付。在現有生產流程的基礎上，我們不斷擴充產能並提升製造能力，以支持我們的銷量增長及不斷變化的客戶需求。

該工廠還設有一個由中國合格評定國家認可委員會（「CNAS」）認證的高標準可靠性測試實驗室。在該實驗室進行的測試及由我們的實驗室頒發的認證均獲得CNAS認可。根據灼識諮詢的資料，該實驗室為華南地區功率半導體器件公司中少數最先進且投資最大的實驗室之一。該實驗室主要對我們的功率半導體器件進行長期穩定性、環境適應性及壽命測試，確保產品在複雜工況下的性能表現。

透過設立並逐步提升我們珠海工廠的產能，我們將更大比例的生產轉為內部進行，從而顯著改善了盈利能力。具體而言，我們內部製造的WLCSP產品的單位成本始終低於外包加工的單位成本。由於內部製造WLCSP產品的比例不斷增加，自2024年至2025年，WLCSP產品的整體單位成本下降約23.4%，而截至2026年5月31日止五個月較2025年同期下降約7.7%。我們的毛利率從投產前2024年的17.4%增加至2025年的23.6%。該改善主要受惠於對外部承包商的依賴減少及外包費用降低，加上產量增加實現規模經濟，使固定成本得以攤分至更大的產量基礎。我們的毛利率由截至2025年5月31日止五個月的22.4%下降至截至2026年5月31日止五個月的17.9%。該跌幅主要歸因於市場主導的定價調整。我們持續的成本效益部分抵銷了行業對定價的影響，從而限制了整體毛利率的收窄幅度。擴充內部產能亦提升了我們的成本競爭力及營運應變能力，從而支持更高的交易量及更穩固的客戶關係。

高增長的市場機遇

功率半導體器件作為電能轉換與電路控制的核心元件，其發展與下游市場高度相關。受益於消費電子需求穩健發展、新能源汽車普及和可再生能源加速部署，以及AI技術興起，行業正經歷強勁增長。根據灼識諮詢的資料，中國功率半導體器件市場規模從2021年的人民幣807億元增至2025年的人民幣1,090億元，複合年均增長率為7.8%，預計2030年達人民幣1,804億元，2026年至2030年的複合年均增長率為10.4%。

概 要

先進封裝技術機遇

電子產品小型化、輕量化和高性能需求持續提升，推動封裝技術演進，尤其是WLCSP技術。隨著技術成熟及成本優化，WLCSP有望拓展至更廣泛的半導體產品，驅動行業革新。根據灼識諮詢的資料，中國WLCSP MOSFET行業規模從2021年的人民幣21億元增至2025年的人民幣31億元，複合年均增長率為9.4%，預計2030年達人民幣55億元，2026年至2030年的複合年均增長率為14.3%。

競爭優勢

我們相信，以下優勢將使我們能夠更好地把握未來機遇，實現持續增長：(i)我們在中國功率半導體行業備受認可的市場地位及往績記錄；(ii)我們以WLCSP產品為核心，戰略性把握行業發展機遇；(iii)我們的研發實力打造具成本競爭力的性能產品；(iv)我們以客戶價值導向為基石，長期鎖定頭部客戶；(v)我們的混合業務模式兼具靈活供應鏈保障及核心製造環節自主可控；及(vi)我們經驗豐富的管理層，構建數智化業務並打造強大執行力團隊。

發展戰略

我們計劃採取以下戰略：(i)持續投資WLCSP等先進封裝技術的開發及應用；(ii)堅持研發驅動戰略，加碼研發投入；(iii)聚焦核心應用場景，不斷探索延展機會；(iv)透過自主研發與外部合作，提升供應鏈韌性與品質；及(v)選擇性尋求戰略合作及投資機會。

我們的客戶及供應商

於截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度以及截至2026年5月31日止五個月，我們的五大客戶於各期間合計產生的收入分別為人民幣280.4百萬元、人民幣335.6百萬元、人民幣469.0百萬元及人民幣239.9百萬元，分別佔我們總收入的48.7%、53.8%、57.6%及67.9%。此外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年5月31日止五個月，來自最大客戶的收入於各期間分別佔總收入的13.8%、16.6%、23.1%及29.7%。詳情請參閱「業務－我們的客戶」。

於截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度以及截至2026年5月31日止五個月，我們向五大供應商於各年度的採購額分別為人民幣359.8百萬元、人民幣397.3百萬元、人民幣493.3百萬元及人民幣218.8百萬元，分別佔我們採購總額的80.5%、81.1%、71.3%及70.1%。此外，於截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度以及截至2026年5月31日止五個月，我們於各年度向最大供應商的採購額分別佔採購總額的29.5%、47.7%、21.7%及19.9%。詳情請參閱「業務－我們的供應商」。

競爭

我們所在的功率半導體器件行業競爭激烈，其特點是技術發展迅速，客戶需求及偏好變化快，新產品及服務推出頻繁，新行業標準及實踐不斷湧現。

概 要

根據灼識諮詢的資料，中國功率半導體器件行業仍相對集中，前十大企業的收入佔國內市場份額的一半以上。該等企業在硅、碳化硅、氮化鎵等核心功率技術上處於領先地位，長期主導消費電子、汽車電子、工業應用、新興AI等高端應用領域，形成了穩定的供給框架。

與此同時，中國企業雖然規模相對較小，但在國內需求和下游行業增長的推動下，憑藉技術創新能力迅速擴大了市場份額。儘管大多數中國企業仍專注於中低端市場，但隨着本地化的推進以及對工藝升級及封裝技術的投資擴大，其在全球格局中的影響力有望增強。縮小與海外成熟企業的技術差距仍然是首要任務，尤其是在中國推動在核心功率半導體器件元件方面提高自給自足能力和競爭力之際。有關我們面臨的競爭格局的更多資料，請參閱「行業概覽」。

風險因素

我們認為我們的業務涉及若干風險及不確定性，部分超出了我們的控制。我們已將該等風險及不確定性分類為：(i)與我們的業務和行業相關的風險；(ii)與在我們開展業務的司法管轄區開展業務有關的風險；及(iii)與[編纂]有關的風險。我們面臨的部分主要風險包括但不限於：(i)我們所處的行業競爭激烈。如果我們未能成功與其他市場參與者競爭，我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響；(ii)新的科技成果或趨勢可能使我們的產品失去競爭力並遭淘汰；(iii)我們的產品主要供特定行業及領域的終端客戶使用。對這些行業及領域或任何特定終端客戶造成不利影響的因素可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；(iv)我們大部分的收入都來自分銷網絡。任何來自經銷商的銷售額下降或經銷商的流失都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響；及(v)由於各種因素，我們經營的市場規模和我們產品的需求可能不會如我們預期的那樣快速增長，這將對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。

歷史財務資料概要

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告所載綜合財務資料連同相關附註及本文件「財務資料」所載資料一併閱讀。

綜合損益表概要

下表載列截至所示年度我們綜合損益表的主要項目：

	截至12月31日止年度						截至5月31日止五個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
收入	575,477	100.0	624,259	100.0	814,135	100.0	347,187	100.0	353,267	100.0
銷售成本	(488,075)	(84.8)	(515,370)	(82.6)	(621,974)	(76.4)	(269,310)	(77.6)	(290,036)	(82.1)
毛利	87,402	15.2	108,889	17.4	192,161	23.6	77,877	22.4	63,231	17.9
年度利潤	13,977	2.4	19,353	3.1	50,516	6.2	26,529	7.6	(510)	(0.1)

概 要

按產品劃分的收入

下表載列我們於所示期間按產品劃分的收入，以絕對金額及佔總收入的百分比呈列：

	截至12月31日止年度						截至5月31日止五個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中低壓功率半導體										
器件.....	536,089	93.1	561,565	90.0	765,658	94.0	321,967	92.7	342,815	97.0
WLCSP產品	161,345	28.0	243,872	39.1	321,037	39.4	160,672	46.3	96,686	27.4
非WLCSP產品	374,744	65.1	317,693	50.9	444,621	54.6	161,295	46.4	246,129	69.6
高壓功率半導體										
器件.....	6,801	1.2	10,076	1.6	13,113	1.7	6,605	1.9	4,264	1.2
其他 ⁽¹⁾	32,587	5.7	52,618	8.4	35,359	4.3	18,615	5.4	6,188	1.8
總計	575,477	100.0	624,259	100.0	814,135	100.0	347,187	100.0	353,267	100.0

附註：

(1) 其他主要包括銷售晶圓及提供加工服務及可靠性測試服務的收入。

按產品劃分的毛利及毛利率

下表載列我們在所示期間按產品劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度						截至5月31日止五個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
產品銷售										
中低壓功率半導體器件..	113,011	21.1	122,460	21.8	188,840	24.7	76,518	23.8	63,943	18.7
WLCSP產品	32,855	20.4	45,243	18.6	101,660	31.7	46,263	28.8	23,097	23.9
非WLCSP產品	80,156	21.4	77,217	24.3	87,180	19.6	30,255	18.8	40,846	16.6
高壓功率半導體器件 ...	538	7.9	(2,354)	(23.4)	(5,586)	(42.6)	(1,890)	(28.6)	633	14.8
其他 ⁽¹⁾	4,833	14.8	10,990	20.9	10,181	28.8	5,476	29.4	1,529	24.7
小計	118,382	20.6	131,096	21.0	193,435	23.8	80,104	23.1	66,105	18.7
存貨撇減.....	30,980		22,207		1,274		2,227		2,874	
總計	87,402	15.2	108,889	17.4	192,161	23.6	77,877	22.4	63,231	17.9

附註：

(1) 其他主要包括銷售晶圓及提供加工服務及可靠性測試服務。

概 要

非國際財務報告準則財務計量

為對我們按國際財務報告準則呈列的綜合財務報表作出補充，我們亦採用經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）作為額外財務計量。該等計量並非國際財務報告準則所要求，亦非按其呈列。我們認為，通過消除若干項目的潛在影響，該等非國際財務報告準則計量有利於比較不同期間及不同公司的經營業績。其為[編纂]及其他持份者提供有用資料，有助彼等以其協助我們管理層一致的方式了解及評估我們的綜合經營業績。儘管如此，我們呈列的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）及經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司呈列之類似名稱的計量進行比較。使用該等非國際財務報告準則計量作為分析工具具有其局限性，閣下不應將其孤立看待，或將其作為我們根據國際財務報告準則報告的經營業績或財務狀況分析的替代。我們將經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）定義為就以股份為基礎的付款及[編纂]作出調整後的年內／期內利潤。下表載列我們於所示年度／期間的年內／期內利潤／（虧損）與經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）的對賬。

	截至12月31日止年度			截至5月31日止五個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年內／期內淨利潤／ （虧損）.....	13,977	19,353	50,516	26,529	(510)
加：					
以股份為基礎的付款開支 ⁽¹⁾ .	(2,395)	298	5,357	1,506	3,966
[編纂].....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
年內／期內經調整 淨利潤（非國際財務 報告準則計量）.....	11,582	19,651	67,066	28,035	9,812

附註：

- (1) 我們於2023年確認以股份為基礎的付款開支撥回人民幣2.4百萬元，主要由於核心管理人員離職。

選定財務狀況表項目概要

下表載列截至所示日期我們綜合財務狀況表中的部分資料：

	截至12月31日			截至5月31日
	2023年	2024年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總值.....	203,299	284,178	348,156	459,428
流動資產總值.....	542,163	526,942	591,129	571,581
資產總值.....	745,462	811,120	939,285	1,031,009
非流動負債總額.....	30,804	79,701	65,773	118,203
流動負債總額.....	113,932	111,078	197,386	233,235
負債總額.....	144,736	190,779	263,159	351,438
流動資產淨值.....	428,231	415,864	393,743	338,346
資產淨值.....	600,726	620,341	676,126	679,571

概 要

我們的資產淨值自2023年至2025年呈現增加趨勢，主要由於各年均錄得利潤。與2025年12月31日相比，截至2026年5月31日，我們的淨資產保持相對穩定，為人民幣679.6百萬元。

綜合現金流量表概要

下表載列於所示期間的選定現金流量表數據：

	截至12月31日止年度			截至5月31日止五個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所得／(所用)					
現金淨額	31,165	58,154	89,062	(21,647)	(54,127)
投資活動所用現金淨額 ...	(50,323)	(150,579)	(97,186)	(40,807)	(64,407)
融資活動所得／(所用)					
現金淨額	29,975	52,639	23,700	(142)	49,022
現金及現金等價物					
增加／(減少)淨額	10,817	(39,786)	15,576	(62,596)	(69,512)
年初現金及現金等價物 ...	201,548	212,170	172,476	172,476	187,496
匯率變動的影響淨額	(195)	92	(556)	(308)	(177)
年末現金及現金等價物 ...	212,170	172,476	187,496	109,572	117,807

主要財務指標

下表載列我們截至所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日或截至12月31日止年度			截至5月31日或 截至5月31日 止五個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
毛利率	15.2%	17.4%	23.6%	17.9%
淨利潤率	2.4%	3.1%	6.2%	(0.1)%
權益回報率 ⁽¹⁾	2.3%	3.2%	7.8%	(0.1)%
總資產回報率 ⁽²⁾	2.0%	2.5%	5.8%	(0.1)%
流動比率 ⁽³⁾	4.8	4.7	3.0	2.5
資產負債比率 ⁽⁴⁾	24.1%	30.8%	38.9%	51.7%

概 要

附註：

- (1) 權益回報率乃按各年度／期間的淨利潤除以權益總額的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (2) 總資產回報率乃按各年度／期間淨利潤除以總資產的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (3) 流動比率乃按截至所示日期的流動資產除以流動負債計算。
- (4) 資產負債比率乃按債務總額除以各日期末的權益總額，再乘以100%計算。

法律訴訟及不合規

我們可能不時捲入我們業務的日常經營引起的糾紛或法律訴訟。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟（包括任何破產或接管程序）。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。有關我們需遵守的法律法規的詳情，請參閱「監管概覽」。

我們的控股股東

緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，李先生連同其控制的實體（即舟山拓緯及舟山集成）將共同於[編纂]股股份（相當於我們全部已發行股份及本公司投票權的約[編纂]%）中擁有權益並控制該等股份。因此，[編纂]後，李先生、舟山拓緯及舟山集成將構成一組控股股東。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

[編纂]前投資

我們從[編纂]前投資者獲得股權融資，以支持我們不斷擴展的業務營運。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的全部所得款項均已動用。詳情請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－有關我們的[編纂]前投資者的資料」。

[編纂]

概 要

[編纂]

股息

在本公司股東或董事（如適用）批准派發股息期間，向股東分派股息確認為負債。於往績記錄期間，本公司概無派付或宣派任何股息。截至最後實際可行日期，我們並無正式股息政策或預先釐定的派息率。

於[編纂]完成後，我們可以現金或組織章程細則准許的其他方式分派股息。任何建議分派的股息應由董事會制定，並須經股東批准。日後宣派或支付任何股息的決定，以及任何股息金額，將取決於多項因素，包括我們的盈利及財務狀況、營運需求、資本需求、業務前景、宣派及派付股息上的法定、監管及合約限制，以及董事可能認為屬重要的任何其他因素。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍中位數），經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂]淨額約[編纂]港元（相等於約人民幣[編纂]元）。根據我們的策略，我們擬將[編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計將用於新建一個生產基地。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於加強研發能力及撥資關鍵研發項目。

概 要

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於審慎進行戰略投資及收購。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元，預計用於營運資金及一般企業用途。

進一步詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

[編纂]開支

[編纂]開支指[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用（例如酌情激勵費）。我們估計[編纂]開支將約為人民幣[編纂]元（或[編纂]港元，佔[編纂]總額[編纂]%）（假設[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）且並無行使[編纂]），其中(i)約人民幣[編纂]元與發行[編纂]直接相關，其後將於建議[編纂]完成後自權益中扣除；(ii)人民幣[編纂]元及人民幣[編纂]元已分別於截至2025年12月31日止年度及截至2026年5月31日止五個月的綜合損益表支銷；及(iii)約人民幣[編纂]元預期將於2026年5月31日後的綜合損益表支銷。在該等估計[編纂]開支總額中，我們預期支付[編纂]開支人民幣[編纂]元、法律顧問及申報會計師專業費用人民幣[編纂]元以及其他費用及開支人民幣[編纂]元。

近期發展及無重大不利變動

自2026年5月31日起及直至最後實際可行日期，我們的業務運營保持穩健。在工業應用領域（主要包括工業級無人機(UAV)系統及儲能應用）下游需求增長帶動銷量增長的推動下，我們的收入與2025年同期相比持續增長。同時，我們對智能手機製造商、汽車電子領域的銷售有所減少，晶圓銷售亦有所下降。

無重大不利變動

董事確認，自2026年5月31日（即我們最近一期綜合財務報表的結束日期）直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況或前景未發生重大不利變動，且自2026年5月31日以來並無任何事件會對本文件附錄一會計師報告所載資料產生重大影響。